

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設及び排出基準

〈大気〉

(単位：ng-TEQ/N m³) ng：ナノグラム

特定施設の種類	施設規模	新設排出基準	既設排出基準
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉 (原料処理能力 1t/時以上)		0.1	1
製鋼用電気炉(変圧器定格容量 1,000kVA 以上)		0.5	5
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉(原料処理能力 0.5t/時以上)		1	10
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、乾燥炉(原料処理能力 0.5t/時以上)及び溶解炉(容量 1t 以上)		1	5
廃棄物焼却炉 (火床面積 0.5 m ² 以上又は焼却能力 50kg/時以上)	4t/時以上	0.1	1
	2t/時以上 4t/時未満	1	5
	2t/時未満	5	10

(※) 既設：平成 12 年 1 月 15 日以前に設置され、又は設置の工事がされている施設

〈水質〉

(単位：pg-TEQ/l) pg：ピコグラム

特定施設の種類	排出基準
1 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10
2 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	
3 硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設	
4 アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設	
5 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設	
6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	
7 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設	
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設及び廃ガス洗浄施設	
9 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設	

特定施設の種類		排出基準
10	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設	10
11	ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設・還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設・還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設	
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	
13	亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	
14	担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供するろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設	
15	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設	
16	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設	
17	フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	
18	下水道終末処理施設(1~17及び19に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)	
19	1~17までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	

〈廃棄物最終処分場関係〉

対象施設	規制内容	基準
特定施設である廃棄物焼却炉	・ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処理基準	3 ng-TEQ/g(※)
廃棄物最終処分場	・維持管理基準(放流水の水質基準) ・ばいじん等の飛散、流出防止措置の義務付け	10 pg-TEQ/l —

(※) 平成12年1月15日以前に設置され、又は設置の工事がされている施設から排出され、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行ったものは、基準を適用しない。